PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 66, DE 12 DE MARÇO DE 2008

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 2-do art. 4-da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1-do art. 2-, e nos artigos 16 a 19 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MDIC no 01200.007092/2001-54, de 14 de janeiro de 2002, Resolvem:

Art. 1. Os Processos Produtivos Básicos para os produtos CARTÕES INTELIGENTES (smart cards), industrializados no País, estabelecidos pela Portaria Interministerial MDIC/MCT n. 243, de 13 de dezembro de 2006, passam a ser os seguintes:

I - CARTÕES INTELIGENTES COM CONTATO - LAMINADO:

- a) fresamento da cavidade do cartão plástico;
- b) separação e preparação do módulo do microchip;
- c) aplicação do adesivo na cavidade do cartão; e
- d) fixação do módulo do microchip no cartão.

II - CARTÕES INTELIGENTES COM CONTATO - INJETADO:

- a) injeção plástica do cartão;
- b) separação e preparação do módulo do microchip;
- c) aplicação do adesivo na cavidade do cartão; e
- d) fixação do módulo do microchip no cartão.

III - CARTÕES INTELIGENTES SEM CONTATO:

- a) fresagem da folha de PVC (formação do calço);
- b) impressão das folhas de PVC, quando aplicável;
- c) montagem do microchip na antena; e
- d) fusão (laminação) do conjunto calço, antena, folhas de PVC e folha de cristal de PVC.
- $\$ 1 \cdot Todas as etapas dos Processos Produtivos Básicos acima descritas deverão ser realizadas no País.
- § 2-As atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto as etapas "c", e "d" dos incisos I e II e a alínea "d" do inciso III, que não poderão ser objeto de terceirização.
- § 3 Fica dispensado, até 30 de setembro de 2008, o cumprimento da etapa constante da alínea "a" do inciso II deste artigo. § 4 Os cartões plásticos mencionados no inciso I deverão ser produzidos no País a partir da fusão das folhas plásticas. Art. 2 Os circuitos integrados monolíticos ou microchips mencionados nos incisos I, II e III do art. 1 deverão atender, a partir de 1 de janeiro de 2009, ao seguinte Processo Produtivo Básico, para um percentual mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da produção do ano calendário.
 - I montagem de pastilha semicondutora, não encapsulada;
 - II encapsulamento da pastilha montada;
 - III teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e IV marcação (identificação).

- § 1. Os circuitos integrados monolíticos ou microchips de que trata este artigo poderão ser adquiridos de terceiros, desde que cumpra o Processo Produtivo Básico estabelecido neste artigo. § 2. A obrigatoriedade estabelecida no caput deste artigo deixa de ser exigida no período correspondente a 1. de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2008.
- § 3. Que haja compromisso das empresas na promoção de processo de desenvolvimento de fornecedores para o cumprimento das etapas estabelecidas no caput deste artigo, por meio da apresentação relatórios semestrais das ações efetivamente, realizadas na localização dos potenciais fornecedores para o encapsulamento dos circuitos integrados, que deverão ser apresentados 6 (seis) meses a contar da publicação desta Portaria, sendo que a implementação das ações não deverão ultrapassar a 6 (seis) meses da data do termino da dispensa.
- Art. 3 Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa dos Processos Produtivos Básicos poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, através de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.
- Art. 4 Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT n_o 243, de 13 de dezembro de 2006.

Art. 5-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL JORGE

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior SERGIO MACHADO REZENDE Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia